

Frore Systems 推出 AirJet® PAK 2025 年嵌入式奖提名者

解锁紧凑型嵌入式系统中 AI 性能的关键

加利福尼亚州圣何塞 – 2025 年 2 月 27 日：Frore Systems 通过推出革命性的 **AirJet® PAK**——全球首款固态主动冷却模块，正在变革嵌入式系统行业。该产品已入围德国嵌入式世界大会（2025 年 3 月 11-13 日）的 **2025 嵌入式奖（Embedded Award）** 提名。这一年度奖项表彰嵌入式系统技术领域的杰出创新。**Frore Systems 的 AirJet® PAK** 有望重新定义如何解决限制 AI 性能的首要挑战：热量。

嵌入式系统中的 AI 革命需要 AirJet® PAK

嵌入式系统无处不在。这些专用计算机被设计来执行特定功能，隐藏在我们日常使用的设备中——智能家居产品、医疗器械、汽车、智慧城市和工业设备。它们小巧、高效，默默驱动现代生活。然而，嵌入式系统中人工智能的快速发展带来了难题：高性能 AI 处理器产生的热量成为持续巅峰性能的关键障碍。全新的 **AirJet® PAK** 冷却模块提供终极解决方案，高效移除热量，确保嵌入式系统始终保持最佳性能，无任何妥协。

AirJet®PAK 是一款超紧凑、即插即用的冷却模块，防尘、防水且完全无声。

重新定义 AI 散热

传统冷却方法（如笨重的散热片和嘈杂的风扇）在苛刻环境下力不从心。风扇将灰尘和湿气吸入设备导致故障，而散热片则增加体积和重量。**AirJet®PAK** 彻底改变局面：

- **更小更轻的设计**：使用 **AirJet®PAK** 的系统比传统被动散热方案显著更小更轻。
- **无与伦比的耐用性**：无易损移动部件，**AirJet PAK** 提供传统风扇无法比拟的长期可靠性。
- **广泛兼容性**：专为多种嵌入式 AI 系统设计，包括 NVIDIA Jetson、Qualcomm、NXP 和 AMD/Xilinx SoM 模块，释放所有嵌入式应用的 AI 潜力。

例如，NVIDIA Jetson Orin NX 16GB（高达 100 TOPS）需要高效散热才能充分发挥潜力。**AirJet®PAK** 提供与传统被动方案相同的性能，但体积和重量减少 85%，彻底革新系统设计。

每种尺寸皆具强大性能

AirJet®PAK 模块提供多种配置，满足不同应用需求：

- **AirJet®PAK 5C**：移除高达 33W 热量，支持 100 TOPS，尺寸仅 100x65x9.3mm。
- **AirJet®PAK 3C**：移除高达 24W 热量，支持 80 TOPS，尺寸仅 100x65x5.8mm。
- **AirJet®PAK 1C**：移除高达 9W 热量，支持 28 TOPS，尺寸仅 30x65x5.8mm。

AirJet®PAK 系统内置可扩展性，多个模块可组合应对更高处理负载和更大热量散发，是未来 AI 设计的理想选择。



颠覆嵌入式行业——Frore Systems 不仅在解决问题，更在变革嵌入式系统行业。通过释放紧凑、坚固嵌入式系统中 AI 的全部潜力，**AirJet®PAK** 为冷却方案设立了新标准。Frore Systems 向世界展示，当热量不再是阻碍时，一切皆有可能。

Frore Systems 将参加 2025 年 3 月 11-13 日在德国举办的嵌入式世界大会，届时将展示 AirJet®PAK 的现场演示，包括多款搭载 AirJet®PAK 的嵌入式系统，并展出已上市的 AirJet 商用产品。这些突破性产品为所有嵌入式 AI 系统解锁所需性能。

关于 Frore Systems

Frore Systems 是电子和消费设备突破性热管理技术的开发者。其主动冷却解决方案——AirJet®Mini、AirJet®Mini Slim、AirJet®Mini Sport 和 AirJet®PAK——被集成到设备中，静音移除热量，实现显著性能提升，同时打造更薄、更轻、无声、无振、防尘、防水的设备。Frore Systems 总部位于美国加州圣何塞，并在台湾设有办公室和制造工厂。了解更多信息，请访问：<https://froresystems.com/>

更多信息联系方式：

Sue Ryan - Frore Systems 市场营销部副总裁

邮箱：sue@froresystems.com

电话：+1 314 914 5008

